

# 信頼性試験結果

## Reliability Test

XC9291 シリーズ

XC9291 Series

パッケージ

Package

LGA-6B01

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&amp;アンチモンフリー / Halogen &amp; Antimony-Free

| No. | 試験項目<br>Test Item                        | 試験条件<br>Test Conditions                                                                                                           |                        | 時間<br>Hours   | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1   | 高温バイアス<br>High Temperature Bias          | 125°C VIN=6.7V, VOUT=0.6V                                                                                                         |                        | 1000          | 0/22                  |
| 2   | 高温保存<br>High Temperature Storage         | 150°C                                                                                                                             |                        | 1000          | 0/22                  |
| 3   | 高温高湿バイアス<br>Temperature Humidity Bias    | 85°C85%RH VIN=6.7V, VOUT=3.0V                                                                                                     |                        | 1000          | 0/22                  |
| 4   | 温度サイクル<br>Temperature Cycle              | -65°C~150°C 各30分<br>30min each                                                                                                    |                        | 100CYC.       | 0/22                  |
| 5   | プレッシャークーカーバイアス<br>HAST                   | 130°C85%RH $2 \times 10^5$ Pa VIN=6.7V, VOUT=3.0V                                                                                 |                        | 100           | 0/22                  |
| 6   | プレッシャークーカー<br>UHAST                      | 130°C85%RH $2 \times 10^5$ Pa                                                                                                     |                        | 100           | 0/22                  |
| 7   | はんだ耐熱<br>Resistance to<br>Soldering Heat | 85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times<br>Moisture Sensitivity Level 1<br>Based on IPC/JEDEC J-STD-020 |                        | -             | 0/11                  |
| 8   | 静電耐圧<br>Electric Static Discharge        | MM                                                                                                                                | R=0Ω C=200pF ±200V     | 3回<br>3 times | 0/5                   |
|     |                                          | HBM                                                                                                                               | R=1500Ω C=100pF ±1kV   | 3回<br>3 times | 0/5                   |
|     |                                          | CDM                                                                                                                               | ±500V                  | 3回<br>3 times | 0/5                   |
| 9   | ラッチアップ<br>Latch-Up                       | E-test                                                                                                                            | VIN=9.0V Pulse Voltage | 1回<br>1 time  | 0/5                   |
|     |                                          | I-test                                                                                                                            | ±100mA                 | 1回<br>1 time  | 0/5                   |

## パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

| No. | 試験項目<br>Test Item                | 試験条件<br>Test Conditions                                                                            |  | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 1   | 接合強度試験<br>Adhesive Strength Test | PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403)<br>apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec. |  | 0/5                   |
| 2   | 基板反り試験<br>Bending Test           | たわみ量 5mm 5±1s 1回 (EIAJ ED4702)<br>Strain 5mm 5±1s 1time (EIAJ ED4702)                              |  | 0/5                   |
| 3   | はんだ付け性<br>Solderability          | 230°C10秒(プロファイル昇温法)<br>230°C 10s (Temperature profile method )                                     |  | 0/11                  |